

# 北京工厂电子物料收购工厂积压电子料 收各地元器件

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 北京工厂电子物料收购工厂积压电子料<br>收各地元器件       |
| 公司名称 | 深圳市宝安区友鸿志辉电子回收商行                  |
| 价格   | 33.00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:IC<br>型号:BGA<br>产地:深圳          |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区西坊村81号101<br>(经营场所) |
| 联系电话 | 13711870027                       |

## 产品详情

，先在芯片表面涂抹一层焊膏。(有助于沾锡)

2，运用烙铁对芯片上的锡球进行简单清洁。

3，用吸锡线再次对芯片上的锡点进行再次清洁，直到清洁平整。(可以用手触摸一下，不划手即可)

4，清洁之后再次对芯片进行焊膏的涂抹。这次一定要轻轻涂抹，尽量要薄。(多了会化成水，影响植锡)

5，涂抹完后将芯片放在纸上(四周折一下，防止锡球滚动)

6, 找一张合适的钢网(清洁后的钢网), 对应芯片的锡点, 将钢网与锡点对应。

7, 需要分清芯片所需锡球的大小, 将合适的锡球轻撒在钢网上。

8, 把撒在钢网上的锡球吹到合适的点位。锡球归位后, 拿出钢网。

IC 产品的质量及后续生产环节的顺利进行。外观检测的方法有三种：一是传统的手工检测方法，主要靠目测，手工分检，可靠性不高，检测效率较低，劳动强度大，检测缺陷有疏漏，无法适应大批量生产制造；二是基于激光测量技术的检测方法，该方法对设备的硬件要求较高